

LASER CUTTING SYSTEM

SP-SERIES

產品特性

- ▲ 密封式結構設計，上蓋透視窗方便觀看機器工作狀態。
- ▲ 獨立CCD設計，方便安裝操作。
- ▲ 壓環鏡架設計，增加鏡片穩定性。
- ▲ 輕型運動結構，可使用快速切割。
- ▲ 平台式前後穿透設計，方便長型或捲型材料切割
- ▲ 集料抽風設計，方便客戶清理殘料。
- ▲ 兼具切割與向量雕刻功能，可一次完成切割、半切穿(kiss cutting)或表面蝕刻處理。



產品優點

- ▲ 中文化觸控介面，使客戶方便操作。
- ▲ 中文化軟體操作介面，接受多類型向量圖型檔案。
- ▲ 模組化設計，方便維修。
- ▲ 聚焦鏡組採用線性滑軌設計，增加切割穩定性。
- ▲ 即時監控設計，掌握機器各項狀態。
- ▲ 少量多樣化，彈性生產，減少材料損失。
- ▲ 具工作計時功能，方便掌握加工時間。
- ▲ 應用範圍廣泛，加工隙縫狹小。

適用材料

- ▲ 壓克力、密集板、布料、皮革、厚紙片、橡膠、泡棉、玻利、塑膠、地毯、電木、EVA、軟木、不織布.....等非金屬材料。

系統規格

機型	SP-SERIES
雷射功率	DC100/DC130/RF25/60/100/200/400 Watts
冷卻方式	氣/水冷式
電力需求	220V，三相，50A，50/60Hz(60/100W)
重量	450KG
機器尺寸	1920X 1450 X1320(長 寬 高)
控制方式	CNC Commands (G, M code)
電腦連線方式	RS-232 CONNECT PORT
記憶體	內建2M(具DNC邊傳邊做功能，無記憶體大小限制)
工作範圍	1300mm x 900mm (長 x 寬)
聚焦鏡	2.0" /3.0" /5.0"
X軸行程	1300mm
Y軸行程	900mm
切割平台	鋁條支撐平台，減少雷射反射光線
軟體	WYTCNC
功率控制	PWM信號控制
定位精度	+/-0.1mm(+/-0.04"))
快速定位精度	30M /min
最快切割速度	15M/min
選配組件	光學尺系統、OPC控制系統



維揚精業有限公司

新竹市牛埔東路526巷17號

電話:03-5387692

傳真:03-5387691

HTTP://www.wytech.com.tw

